

电子工业专用设备

EQUIPMENT FOR ELECTRONIC PRODUCTS MANUFACTURING

2016.7

ISSN 1004-4507
CN62-1077/TN

1971年创刊

设备选型、采购、
应用指导刊物

欢迎访问
www.cepem.com.cn

(总第256期)

《中文核心期刊(遴选)数据库》收录 □ 《中国知网》收录 □ 《中国学术期刊(光盘版)》收录期刊 □ “万方数据-数字化期刊群”全文上网

www.icept.org

ICEPT 2016

第17届电子封装技术国际会议

The 17th International Conference on Electronic Packaging Technology

第十七届电子封装技术国际会议(ICEPT 2016)将于2016年8月16~19日在中国武汉举行。ICEPT会议多年来得到了IEEE-CPMT的全力支持和IMAPS、iNEMI等国际行业组织的积极参与,并得到了中国电子学会、中国科协的高度评价,已成为国际电子封装领域四大品牌会议之一。

会议为期4天,将有来自近20个国家和地区的代表参加。大会将通过展览展示、专题讲座、特邀报告、主题论坛、分会报告、论文张贴等形式交流电子封装技术领域的最新进展。

大会诚邀您参会、参展,共襄盛举!

会议主题

- ◎ 先进封装
- ◎ 系统级封装
- ◎ 封装材料与工艺
- ◎ 封装设计与模拟
- ◎ 互连技术
- ◎ 封装制造技术与设备
- ◎ 质量与可靠性
- ◎ 固态照明封装与集成
- ◎ 微波与功率器件封装
- ◎ 新兴领域封装

Hosted By

CIE

CIE-Electronic Manufacturing and Packaging Technology Society



Technically Sponsored By

IEEE



IEEE COMPONENTS, PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY SOCIETY

Organized By

武汉大学
WUHAN UNIVERSITY

会务组联系方式

北京: 张爽 010-6465 5241 Email: zhangs1189@sina.com

上海: 甘凤华 021-3895 3725 Email: faithsh@yeah.net

2016.8.16 -19.

武汉光谷金盾大酒店

电子工业专用设备

DIANZI GONGYE ZHUANYONG SHEBEI

□1971年创刊 2016年第45卷
□第7期(总第256期) 月刊

www.cepem.com.cn

主 管: 中国电子科技集团公司
主 办: 中国电子科技集团公司第四十五研究所

中国电子专用设备工业协会会刊

编委会成员:(排名不分顺序)

郭叙海 夏克金 刘效贞
蔡 坚 李润源 薛 自
田陆屏 龚 里 韩振兴
童志义 莫大康 孙江燕
周 畅 葛励冲 刘 骏
梁大明 柯建波 李留臣

总 编(兼): 刘济东
副总编(兼): 景 璀 金存忠 黄行早
主 编: 赵 璋
执行编辑: 黄 刚
美术编辑: 罗超霖

编辑出版:《电子工业专用设备》编辑部

地 址: 北京市朝阳区安贞西里26号
浙江大厦913室
邮 编: 100029
电 话: 010-64443110 64655251 64674511
传 真: 010-64676495
地 址: 北京市经济技术开发区泰河三街1号
电 话: 010-57989178
E-mail: 2366931928@qq.com(投稿与新闻)
各地广告服务部:(联系人:黄刚)
北京 电话: 010-64655251
传真: 010-64676495
上海 电话: 021-38953725/26
传真: 021-38953726

印 刷: 北京中和泰达印刷设计有限公司
发 行:《电子工业专用设备》编辑部
出版日期: 2016年7月20日

中国连续 ISSN 1004-4507
出版物号 CN62-1077/TN

广告经营许可证: 6227004000010
发行范围: 国内外公开发
定 价: 18.00元/期

CONTENTS

目次

1 趋势与展望

- 第十四届中国半导体封装测试技术与市场年会成功召开
.....本刊通讯员(1)
- 2015年中国半导体设备经济运行分析和2016年展望
.....金存忠(4)

6 太阳能光伏技术与设备

- 晶体硅太阳能组件焊接技术的优化研究
.....张福家, 李 韬, 杨 摇(6)
- 低压扩散机理及其对扩散方阻均匀性的影响研究
.....张宝锋, 陈 晖(10)
- 硅片上下料设备中精度公差对稳定性影响的分析
.....杨 杰(15)

18 电子专用设备研究

- LTCC生瓷切片机切刀组件的设计
.....王海珍, 王 宁, 杨 卫, 等(18)
- 划片机防水系统的设计
.....秦 江, 吕 超, 崔 岳, 等(21)

□期刊基本参数: CN62-1077/TN*1971*m*16*84*zh*P*¥18.00*1500*14*2016-7

气囊在平板显示贴附类设备中的应用与研究

.....胡钦华, 郭 鹏, 杨成春, 等(24)

同步带传动在大型电子专用设备中的应用研究

.....李庆亮, 王起飞, 王 敏(29)

松下PLC的链接控制探讨

.....武振海(32)

平行束磁透镜的研究

.....胡振东, 孙雪平, 彭立波(37)

切割室座工艺研究

.....田颖华, 孙士礼, 郭忠华(40)

船载设备防腐涂装工艺研究

.....阳智刚, 龙云泽(44)

47 材料制造工艺与设备

横向磁场中直拉硅单晶生长

.....李贺梅(47)

51 企业之窗

公司与新品介绍.....(51)

63 其它

第十七届电子封装技术国际会议.....[1]

指导委员会成员名单:

(排名不分顺序)

丁文武 国家集成电路产业发展基金投资有限公司总裁

毕克允 中国半导体行业协会副理事长

王阳元 中国科学院院士

叶甜春 02重大专项技术总师、专家组组长

陈 捷 东电电子(上海)有限公司总裁

王 政 中国电子科技集团公司副总经理

武 祥 中电科技集团公司第四十八研究所副所长

王勃华 工业和信息化部电子信息司副巡视员

邹世昌 中国科学院院士

徐小田 中国半导体行业协会执行副理事长

蒋守雷 上海市集成电路行业协会秘书长

尹志尧 中微半导体设备(上海)有限公司董事长

程建瑞 上海微精密机械工程有限公司总经理

王 晖 盛美半导体设备(上海)有限公司董事长

支持单位:

工业和信息化部电子信息司

中国电子专用设备工业协会

中国半导体行业协会

上海市集成电路行业协会

华美半导体协会

中芯国际集成电路制造(上海)有限公司

上海华虹宏力半导体制造有限公司

日月光半导体(上海)有限公司

江苏长电科技股份有限公司

意法半导体(上海)有限公司

台积电(上海)有限公司

飞思卡尔半导体(中国)有限公司

上海中艺自动化系统有限公司

上海微精密机械工程有限公司

2016年(理事单位)





EQUIPMENT FOR
ELECTRONIC PRODUCTS
MANUFACTURING

Administrator:

China Electronics Technology Group Corporation

Sponsor:

the 45th Research Institute of CETC

Publisher & Chief Editor: GUO Yong-xing

Vice Publisher:

TIAN Lu-ping HUANG Xing-zao TONG Zhi-yi

Senior Editor: ZHAO Zhang

Executive Editor: HUANG Gang

Edited and Published by:

Editorial Office of Equipment for Electronic Products
Manufacturing

Add:

East Yanjiao, P. O. Box 220, Beijing 101601, China

Tel: 010-61592958

Fax: 010-61598228

Edited and Produced by:

Beijing Faith Information Advisory Ltd.

Add:

Rm 913, Zhejiang Bldg, No.26 Anzhenxili, Chaoyang
Dist, Beijing 100029, China

Tel: 010-64443110 64655251 64674511

Fax: 010-64676495

Tel: 021-38953725 **Fax:** 021-38953725-604

Email: 2366931928@qq.com

Http: //www.cepem.com.cn

Edition Number: ISSN 1004-4507
CN62-1077/TN

Supporting Units:

China Electronics Technology Group Corporation

China Electronic Products Equipment

Industry Association

China Semiconductor Industry Association

Shanghai IC Industry Association

Shanghai Hua Hong NEC Electronics Co., Ltd.

Grace Semiconductor Manufacturing Corporation

Semiconductor Manufacturing International

(Shanghai) Corp. (SMIC)

• All rights reserved. The contents of this magazine
may not be reproduced in whole or in part without
prior permission of the copyright owner.

CONTENTS

6 PV Technology and Equipment

Research on Improving the Technology of the PV
Models in the Welding Process.....
.....ZHANG Fujia, LI Tao, YANG Yao (6)

Study about Low Pressure Diffusion Mechanism and
its Influence of Diffusion Sheet Resistance Uniformity
.....ZHANG Baofeng CHEN Hui (10)

Analysis of the Influence of Accuracy、Tolerance
on Stability of Wafer Automatic Device.....
.....YANG Jie (15)

18 Researches on Electronic Equipment

Design of the Cutter Assembly for LTCC Slicer.....
.....WANG Haizhen, WANG Ning, YANG Wei, etc (18)

Design of Waterproof System for Dicing Saw.....
.....QIN Jiang, LV Chao, CUI Yue, etc (21)

The Research and Application of Bonnet in Attached
Equipment of the Flat Panel Display.....
.....HU Qinhua, GUO Peng, YANG Chengchun, etc (24)

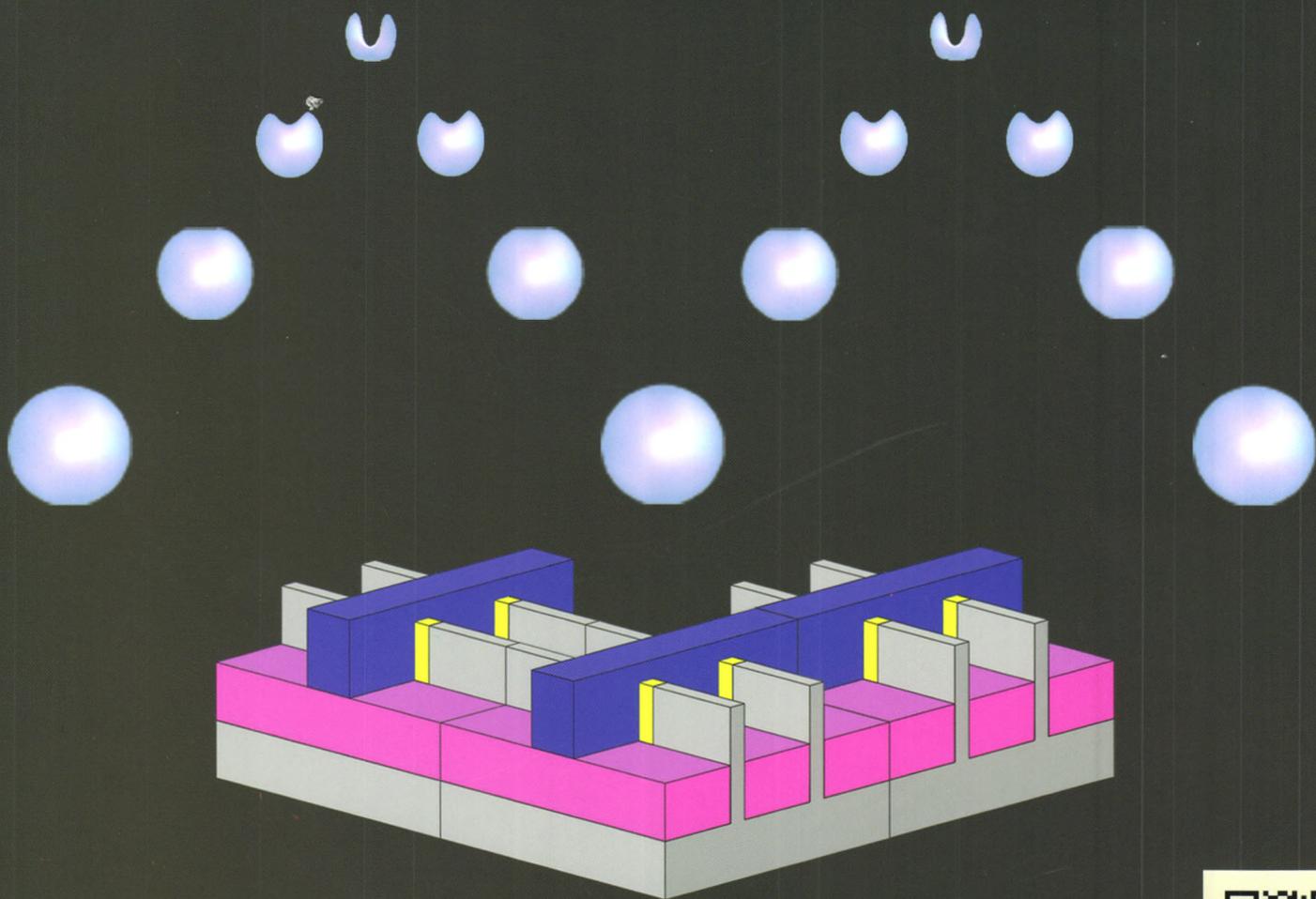
Research of Synchronous Belt Drive on Big Electronic
Production Equipment.....
.....LI Qingliang, WANG Qifei, WANG Min (29)

Discuss about the PLC PC-LINKof Panasonic.....
.....WU Zhenhai (32)



盛美半导体

Your FinFET Yield Up Solution!



ACM Research, Inc.

42307 Osgood Rd. Suite 1, Fremont, CA 94539, USA

Tel: +1-510-4453700 Fax: +1-510-445-3708

ACM Research (Shanghai), Inc.

Add: Bldg 4, No.1690 Cailun Rd., Zhangjiang High-tech Park, Shanghai, PRC

Tel: +86-21-50808868 Fax: +86-21-50808860 Website: www.acmrsh.com

万方数据

ISSN 1004-4507

